

R.O.C Patent No. 564,535

Title: White LED Package

Summary:

5 A white LED package comprises a carrier, an adhesive layer having fluorescent particles therein, a LED chip, a bonding wire, a fluorescence layer and an encapsulation layer, which discloses a structure of lead-frame-type LED.

公告本

申請日期: 91.11.6	IPC分類
申請案號: P1132652	H01L23128

(以上各欄由本局填註)	發明專利說明書	564535
-------------	---------	--------

一、發明名稱	中文	白光發光二極體之封裝結構	
	英文	White LED package	
二、發明人 (共1人)	姓名 (中文)	1. 王佩淇	
	姓名 (英文)	1. Peggy Wang	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 TW	
	住居所 (中文)	1. 台北縣中和市中山路二段25巷5號3樓	
	住居所 (英文)	1.	
三、申請人 (共1人)	名稱或姓名 (中文)	1. 銀河光電股份有限公司	
	名稱或姓名 (英文)	1. ACME TECHNOLOGIES LTD.	
	國籍 (中英文)	1. 中華民國 ROC	
	住居所 (營業所) (中文)	1. 桃園縣龜山鄉萬壽路一段492-9號2樓 (本地址與前向貴局申請者相同)	
	住居所 (營業所) (英文)	1. 2Fl., No. 492-9, Sec. 1, Wanshou Rd., Gueishan Shiang, Taoyuan, Taiwan 333, R.O.C.	
	代表人 (中文)	1. 蔡政宏	
	代表人 (英文)	1. Cheng-Hung Tsai	

智慧局資料中心所提供之資料，僅供參考；如要作為判斷，仍請洽本局權責單位確認各項資料相關狀態。依判

